
未來計劃及 [編纂] 用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂] 用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)，我們估計，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們將收取的[編纂]淨額約為[編纂]港元。根據我們的戰略，我們擬於未來兩至三年將[編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於提升電解銅箔的產能。具體而言：
 - [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於建設生產設施。
 - [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於採購及安裝生產設備、辦公設備及其他附屬設施。擴建後的設施將配備先進的生產設備，包括生箔機、陰極滾輪、電沉積整流器、高速分切機、表面處理設備、電解液製備設備以及銅材製相關的上游設備(包括上引連鑄銅熔爐及拉絲設備)。
- [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於實施新產品開發的研發計劃、升級現有技術及推動產品迭代，以提升整體競爭力。具體而言：
 - [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於鋰電銅箔產品的研發。我們的研發將專注於(i)高安全性複合銅箔；(ii)適用於高壓實密度負極材料的銅箔；(iii)兼容矽碳負極的高性能銅箔；及(iv)固態電池專用銅箔。為支持上述研發計劃，我們計劃升級研發設備，並招聘研發及技術人員。
 - [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於高端電子電路銅箔產品的研發，以及建立電子電路銅箔研發院並安裝先進研發設施，以支持上述研發工作。我們的研發重點將包括：(i)開發具有超低表面粗糙度的柔性RTF產品；(ii)提升HVLP銅箔產品的黏附性能及熱穩定性；及(iii)推進厚度低於5 μ m的超薄銅箔。為支持上述目標，我們將建立電子電路銅箔研發院，作為集中式技術創

未來計劃及[編纂]用途

新平台，專注於研發、測試以及生產工藝優化、產品性能及質量穩定性的提升。我們亦計劃採購先進研發儀器及測試設備，用於材料性能測試、表面品質檢測、鍍層工藝監控及產品可靠性驗證。

- [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於償還銀行貸款，年利率介乎2.0%至5.0%，將於2027年到期。該等貸款主要用作資助銅箔生產基地的建設及補充營運資金。
- [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為[編纂]範圍的高位數或[編纂]範圍的低位數，則[編纂]淨額將分別增加約[編纂]港元或減少約[編纂]港元。倘[編纂]淨額(包括行使[編纂]淨額)高於或低於預期，我們將按比例調整作上述用途的[編纂]淨額的分配。

倘[編纂]獲悉數行使，本公司將根據每股[編纂]的[編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)並扣除本公司應付的[編纂]費用及佣金後，就[編纂]獲悉數行使時[編纂]及[編纂]的[編纂]股股份，額外收取[編纂]淨額約[編纂]港元。所籌集的額外款項將按比例撥作上述[編纂]用途。

倘因政府政策變化使我們的任何項目進展不可行或發生不可抗力事件等原因，導致我們發展計劃的任何部分未能按計劃進行，我們將審慎評估有關情況，並可能重新分配[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額並未立即用作上述用途，在相關法律法規許可的範圍內，我們僅會將該等未動用[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構(定義見《證券及期貨條例》或其他司法管轄權適用法律法規)的短期計息賬戶。